BEST AVAILABLE CORY

PCT/JP 2004/018628 15.12.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月15日

出 願 番 号 Application Number:

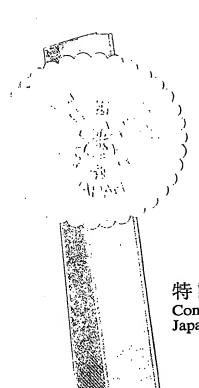
特願2003-416158

[ST. 10/C]:

[JP2003-416158]

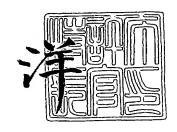
出 願 人
Applicant(s):

TDK株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月27日







【書類名】 特許願 【整理番号】 99P05985

 【提出日】
 平成15年12月15日

 【あて先】
 特許庁長官殿

 【国際特許分類】
 H01G 4/30301

 H01G 4/30301
 H01G 4/30301

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内

【氏名】 佐藤 茂樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【氏名】 野村 武史

【特許出願人】

 【識別番号】
 000003067

 【氏名又は名称】
 TDK株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078031 【氏名又は名称】 大石 皓一

【選任した代理人】

【識別番号】100126468【氏名又は名称】田久保 泰夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074148 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 要約書 1



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

ドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルアセテ ートおよびdージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶 剤を含むことを特徴とするスペーサ層用の誘電体ペースト。

【請求項2】

前記アクリル系樹脂の分子量が45万以上、90万以下であることを特徴とする請求項1 に記載のスペーサ層用の誘電体ペースト。

【請求項3】

前記アクリル系樹脂の酸価が5mgKOH/g以上、25mgKOH/g以下であること を特徴とする請求項1または2に記載のスペーサ層用の誘電体ペースト。



【書類名】明細書

【発明の名称】積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペースト 【技術分野】

[0001]

本発明は、積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペーストに関するものであり、さらに詳細には、スペーサ層に隣接する層に含まれているバインダを溶解することがなく、積層セラミック電子部品に不具合が発生することを効果的に防止することができる積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペーストに関するものである。

【背景技術】

[0002]

近年、各種電子機器の小型化にともなって、電子機器に実装される電子部品の小型化および高性能化が要求されるようになっており、積層セラミックコンデンサなどの積層セラミック電子部品においても、積層数の増加、積層単位の薄層化が強く要求されている。

[0003]

積層セラミックコンデンサによって代表される積層セラミック電子部品を製造するには、まず、セラミック粉末と、アクリル樹脂、ブチラール樹脂などのバインダと、フタル酸エステル類、グリコール類、アジピン酸、燐酸エステル類などの可塑剤と、トルエン、メチルエチルケトン、アセトンなどの有機溶媒を混合分散して、セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストを調製する。

[0004]

次いで、誘電体ペーストを、エクストルージョンコーターやグラビアコーターなどを用いて、ポリエチレンテレフタレート(PET)やポリプロピレン(PP)などによって形成された支持シート上に、塗布し、加熱して、塗膜を乾燥させ、セラミックグリーンシートを作製する。

[0005]

さらに、ニッケルなどの導電体粉末とバインダを、ターピオネールなどの溶剤に溶解して、導電体ペーストを調製し、セラミックグリーンシート上に、導電体ペーストを、スクリーン印刷機などによって、所定のパターンで、印刷し、乾燥させて、電極層を形成する

[0006]

電極層が形成されると、電極層が形成されたセラミックグリーンシートを支持シートから剥離して、セラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットを形成し、所望の数の積層体ユニットを積層して、加圧し、得られた積層体を、チップ状に切断して、グリーンチップを作製する。

[0007]

最後に、グリーンチップからバインダを除去して、グリーンチップを焼成し、外部電極 を形成することによって、積層セラミックコンデンサなどの積層セラミック電子部品が製 造される。

[0008]

電子部品の小型化および高性能化の要請によって、現在では、積層セラミックコンデンサの層間厚さを決定するセラミックグリーンシートの厚さを 3μ mあるいは 2μ m以下にすることが要求され、300以上のセラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットを積層することが要求されている。

[0009]

しかしながら、従来の積層セラミックコンデンサにおいては、セラミックグリーンシートの表面に、所定のパターンで、電極層が形成されるため、各セラミックグリーンシートの表面の電極層が形成された領域と、電極層が形成されていない領域との間に、段差が形成され、したがって、それぞれが、セラミックグリーンシートと電極層を含む多数の積層体ユニットを積層することが要求される場合には、多数の積層体ユニットに含まれたセラミックグリーンシート間を、所望のように、接着させることが困難になるとともに、多数



の積層体ユニットが積層された積層体が変形を起こしたり、デラミネーションが発生する という問題があった。

[0010]

かかる問題を解決するため、誘電体ペーストを、電極層と反対のパターンで、セラミックグリーンシートの表面に印刷し、スペーサ層を、隣り合った電極層間に形成して、各セラミックグリーンシートの表面における段差を解消させる方法が提案されている。

[0011]

このように、隣り合った電極層間のセラミックグリーンシートの表面に、印刷によって、スペーサ層を形成して、積層体ユニットを作製した場合には、各積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面における段差が解消され、それぞれが、セラミックグリーンシートと電極層を含む数多くの積層体ユニットを積層して、積層セラミックコンデンサを作製する場合にも、所望のように、多数の積層体ユニットに含まれたセラミックグリーンシートを接着させることが可能になるとともに、それぞれが、セラミックグリーンシートと電極層を含む数多くの積層体ユニットが積層されて、形成された積層体が変形を起こすことを防止することができるという利点がある。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0012]

しかしながら、セラミックグリーンシート用のバインダとして、広く用いられているブチラール樹脂をバインダとして用いたセラミックグリーンシート上に、スペーサ層を形成するための誘電体ペーストの溶剤として、最も一般的に用いられているターピオネールを溶剤として用いて、調製された誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合には、誘電体ペースト中のターピオネールによって、セラミックグリーンシートのバインダが溶解されて、セラミックグリーンシートが膨潤し、あるいは、部分的に溶解して、セラミックグリーンシートとスペーサ層との界面に空隙が生じたり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じ、積層体ユニットを積層し、焼成して作製された積層セラミックコンデンサ中に、ボイドが発生するという問題があった。さらに、スペーサ層の表面にひびや皺が生じると、その部分は、欠落しやすいため、積層体ユニットを積層して、積層体を作製する工程で、積層体内に異物として混入し、積層セラミックコンデンサの内部欠陥の原因になり、スペーサ層が欠落した部分にボイドが生じるという問題もあった。

[0013]

かかる問題を解決するため、溶剤として、ケロシン、デカンなどの炭素水素系溶剤を用いることが提案されているが、ケロシン、デカンなどの炭素水素系溶剤は、誘電体ペーストに用いられるバインダ成分も溶解しないため、従来用いられているターピオネールなどの溶剤を、ケロシン、デカンなどの炭素水素系溶剤によって完全に置換することができず、したがって、誘電体ペースト中の溶剤が、依然として、セラミックグリーンシートのバインダであるブチラール樹脂に対して、ある程度の溶解性を有しているため、セラミックグリーンシートの厚さがきわめて薄い場合には、セラミックグリーンシートにピンホールやクラックが発生することを防止することが困難であり、また、ケロシン、デカンなどの炭素水素系溶剤は、ターピオネールに比して、粘度が低いため、誘電体ペーストの粘度制御が困難になるという問題もあった。

[0014]

また、特開平5-325633公報、特開平7-21833号公報および特開平7-21833号公報などは、ターピオネールに代えて、ジヒドロターピオネールなどの水素添加ターピオネールや、ジヒドロターピオネールアセテートなどのテルペン系溶剤を提案しているが、ジヒドロターピオネールなどの水素添加ターピオネールや、ジヒドロターピオネールなどの水素添加ターピオネールや、ジヒドロターピオネールアセテートなどのテルペン系溶剤は、依然として、セラミックグリーンシートのバインダであるブチラール樹脂に対して、ある程度の溶解性を有しているため、セラミックグリーンシートの厚さがきわめて薄い場合には、セラミックグリーンシートにピンホールやクラックが発生することを防止することが困難であるという問題があった。



[0015]

したがって、本発明は、積層セラミック電子部品のスペーサ層に隣接する層に含まれて いるバインダを溶解することがなく、積層セラミック電子部品に不具合が発生することを 効果的に防止することができる積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペースト を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

[0016]

本発明者は、本発明のかかる目的を達成するため、鋭意研究を重ねた結果、バインダと して、アクリル系樹脂を用い、溶剤として、リモネン、αーターピニルアセテート、Ιー ジヒドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルア セテートおよびd-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種 の溶剤を用いて、スペーサ層用の誘電体ペーストを調製した場合には、所望のように、バ インダを溶剤に溶解させることができ、プチラール系樹脂をバインダとして用いたセラミ ックグリーンシート上に、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成しても、誘電体 ペースト中に含まれた溶剤によって、セラミックグリーンシートに含まれているバインダ が溶解されることがなく、したがって、セラミックグリーンシートが膨潤し、あるいは、 部分的に溶解して、セラミックグリーンシートとスペーサ層との界面に空隙が生じたり、 あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることを確実に防止することができ、積層 セラミックコンデンサなどの積層セラミック電子部品にボイドが発生することを効果的に 防止し得ることを見出した。

[0017]

したがって、本発明の前記目的は、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 lphaーターピニルアセテート、Iージヒドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリ リルアセテート、i-カルビルアセテートおよびd-ジヒドロカルビルアセテートよりな る群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含むことを特徴とするスペーサ層用の誘電体ペ ーストによって達成される。

[0018]

本発明において、バインダとして、スペーサ層用の誘電体ペーストに含まれるアクリル 系樹脂の分子量は、45万以上、90万以下であることが好ましく、分子量が45万以上 、90万以下のアクリル系樹脂を、スペーサ層用の誘電体ペーストのバインダとして用い ることによって、所望の粘度を有する導電体ペーストおよびスペーサ層用の誘電体ペース トを調製することができる。

[0019]

本発明において、バインダとして、スペーサ層用の誘電体ペーストに含まれるアクリル 系樹脂の酸価は5mgKOH/g以上、25mgKOH/g以下であることが好ましく、 酸価が5mgKOH/g以上、25mgKOH/g以下アクリル系樹脂を、スペーサ層用 の誘電体ペーストのバインダとして用いることによって、所望の粘度を有するスペーサ層 用の誘電体ペーストを調製することができる。

[0020]

また、きわめて薄いセラミックグリーンシートに、内部電極用の導電体ペーストを印刷 して、電極層を形成し、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合には、、 導電体ペースト中の溶剤およびスペーサ層用の誘電体ペースト中の溶剤が、セラミックグ リーンシートのバインダ成分を溶解または膨潤させ、その一方で、セラミックグリーンシ ート中に、導電体ペーストおよ誘電体ペーストが染み込むという不具合があり、ショート 不良の原因になるという問題があるため、電極層およびスペーサ層を、別の支持シート上 に形成し、乾燥後に、接着層を介して、セラミックグリーンシートの表面に接着すること が望ましいことが、本発明者らの研究によって判明しているが、このように、電極層およ びスペーサ層を、別の支持シート上に形成する場合には、電極層およびスペーサ層から、 支持シートを剥離しやすくするため、支持シートの表面に、セラミックグリーンシートと 同じバインダを含む剥離層を形成し、剥離層上に、導電体ペーストを印刷して、電極層を



形成し、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成することが好ましい。このように、セラミックグリーンシートと同様な組成を有する剥離層上に、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合にも、剥離層が、ブチラール樹脂をバインダとして含み、誘電体ペーストが、ターピオネールを溶剤として含んでいるときは、剥離層に含まれたバインダが、誘電体ペーストに含まれた溶剤によって、溶解され、剥離層が膨潤し、あるいは、部分的に溶解し、剥離層とスペーサ層との界面に空隙が生じたり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じ、積層体ユニットを積層し、焼成して作製された積層セラミックコンデンサ中に、ボイドが発生するという問題があった。さらに、スペーサ層の表面にひびや皺が生じると、その部分は、欠落しやすいため、積層体ユニットを積層して、積層体を作製する工程で、積層体内に異物として混入し、積層セラミックコンデンサの内部欠陥の原因になり、スペーサ層が欠落した部分にボイドが生じるという問題があった。

[0021]

しかしながら、本発明によれば、スペーサ層用の誘電体ペーストは、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、αーターピニルアセテート、Iージヒドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルアセテートおよび dージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含んでおり、リモネン、αーターピニルアセテート、Iージヒドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルアセテートおよび dージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートに、バインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、セラミックグリーンシートと同じバインダを含む剥離層を形成し、剥離層上に、導電体ペーストを印刷して、電極層を形成し、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合にも、剥離層が膨潤し、あるいは、部分的に溶解し、剥離層とスペーサ層との界面に空隙が生じたり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることを効果的に防止することが可能になる。

【発明の効果】

[0022]

本発明によれば、積層セラミック電子部品のスペーサ層に隣接する層に含まれているバインダを溶解することがなく、積層セラミック電子部品に不具合が発生することを効果的に防止することができる積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペーストを提供することが可能になる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0023]

本発明の好ましい実施態様においては、ブチラール系樹脂をバインダとして含む誘電体ペーストが調製され、エクストルージョンコーターやワイヤーバーコーターなどを用いて、長尺状の支持シート上に塗布され、塗膜が形成される。

[0024]

ブチラール系樹脂の重合度は、1000以上であることが好ましく、ブチラール系樹脂のブチラール化度は、64%以上、78%以下であることが好ましい。

[0025]

誘電体ペーストを塗布する支持シートとしては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。

[0026]

次いで、塗膜が、たとえば、約50℃ないし約100℃の温度で、約1分ないし約20分にわたって、乾燥され、支持シート上に、セラミックグリーンシートが形成される。

[0027]

乾燥後におけるセラミックグリーンシートの厚さは 3μ m以下であることが好ましく、 さらに好ましくは、 1. 5μ m以下である。



[0028]

次いで、長尺状の支持シートの表面に形成されたセラミックグリーンシート上に、内部 電極用の導電体ペーストが、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などを用いて、所定のパ ターンで印刷され、電極層が形成される。

[0029]

電極層は、乾燥後において、約0. 1μ mないし約5 μ mの厚さに形成されることが好ましく、より好ましくは、約0. 1μ mないし約1. 5μ mである。

[0030]

本実施態様において、導電体ペーストは、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、αーターピニルアセテート、Iージヒドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルアセテートおよび dージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含んでいる。

[0031]

リモネン、 α ーターピニルアセテート、I ージヒドロカルビルアセテート、I ーメントン、I ーペリリルアセテート、i ーカルビルアセテートおよびd ージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートにバインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、きわめて薄いセラミックグリーンシート上に、導電体ペーストを印刷して、電極層を形成する場合においても、導電体ペースト中に含まれた溶剤によって、セラミックグリーンシートに含まれているバインダが溶解されることを効果的に防止することができ、したがって、セラミックグリーンシートの厚さがきわめて薄い場合においても、セラミックグリーンシートにピンホールやクラックが発生することを効果的に防止することが可能になる。

[0032]

導電体ペーストに含まれるアクリル系樹脂の分子量は、45万以上、90万以下であることが好ましく、分子量が45万以上、90万以下のアクリル系樹脂を、導電体ペーストのバインダとして用いることによって、所望の粘度を有する導電体ペーストを調製することができる。

[0033]

また、導電体ペーストに含まれるアクリル系樹脂の酸価は $5 \, \mathrm{mg\, KO\, H/g\, UL}$ 、 $25 \, \mathrm{mg\, KO\, H/g\, UL}$ $25 \, \mathrm{mg\, M/g\, UL}$ $25 \, \mathrm{mg\, M/$

[0034]

電極層の形成に先立って、あるいは、電極層を形成して、乾燥した後に、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α - ターピニルアセテート、I - ジヒドロカルビルアセテート、I - メントン、I - ペリリルアセテート、I - カルビルアセテートおよび d - ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含む誘電体ペーストが、セラミックグリーンシートの表面に、電極層と相補的なパターンで、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などを用いて、印刷されて、スペーサ層が形成される。

[0035]

このように、セラミックグリーンシートの表面に、電極層と相補的なパターンで、スペーサ層を形成することによって、電極層の表面と、電極層が形成されていないセラミックグリーンシートの表面との間に、段差が形成されることを防止することができ、それぞれが、セラミックグリーンシートと電極層を含む多数の積層体ユニットを積層体ユニットを積層して、作製された積層セラミックコンデンサなどの積層電子部品が変形を起こすことを効果的に防止することが可能になるとともに、デラミネーションの発生を効果的に防止することが可能になる。

[0036]

また、上述のように、リモネン、 $\alpha-ターピニルアセテート、<math>I-$ ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、i-カルビルアセテートおよび d-



ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートにバインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、きわめて薄いセラミックグリーンシート上に、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合においても、誘電体ペースト中に含まれた溶剤によって、セラミックグリーンシートに含まれているバインダが溶解され、セラミックグリーンシートが膨潤し、あるいは、部分的に溶解して、セラミックグリーンシートとスペーサ層との界面に空隙が生じたり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることを確実に防止することが可能になる。

[0037]

スペーサ層を形成するための誘電体ペーストに含まれるアクリル系樹脂の分子量は、45万以上、90万以下であることが好ましく、分子量が45万以上、90万以下のアクリル系樹脂を、スペーサ層用の誘電体ペーストのバインダとして用いることによって、所望の粘度を有する誘電体ペーストを調製することができる。

[0038]

また、アクリル系樹脂の酸価は5mgKOH/g以上、25mgKOH/g以下であることが好ましく、酸価が5mgKOH/g以上、25mgKOH/g以下アクリル系樹脂を、スペーサ層用の誘電体ペーストのバインダとして用いることによって、所望の粘度を有する誘電体ペーストを調製することができる。

[0039]

次いで、電極層あるいは電極層およびスペーサ層が乾燥されて、支持シート上に、セラミックグリーンシートと、電極層あるいは電極層およびスペーサ層が積層された積層体ユニットが作製される。

[0040]

積層セラミックコンデンサを作製するにあたっては、積層体ユニットのセラミックグリーンシートから、支持シートが剥離され、所定のサイズに裁断されて、所定の数の積層体ユニットが、積層セラミックコンデンサの外層上に積層され、さらに、積層体ユニット上に、他方の外層が積層され、得られた積層体が、プレス成形され、所定のサイズに裁断されて、多数のセラミックグリーンチップが作製される。

[0041]

こうして作製されたセラミックグリーンチップは、還元ガス雰囲気下に置かれて、バインダが除去され、さらに、焼成される。

[0042]

次いで、焼成されたセラミックグリーンチップに、必要な外部電極などが取り付けられて、積層セラミックコンデンサが作製される。

[0043]

本実施態様によれば、セラミックグリーンシート上に、電極層と相補的なパターンで、スペーサ層が形成されるから、電極層の表面と、電極層が形成されていないセラミックグリーンシートの表面との間に、段差が形成されることを防止することができ、したがって、それぞれが、セラミックグリーンシートと電極層を含む多数の積層体ユニットを積層体ユニットを積層して、作製された積層セラミックコンデンサなどの積層電子部品が変形を起こすことを効果的に防止することが可能になるとともに、デラミネーションの発生を効果的に防止することが可能になる。

[0044]

さらに、本実施態様によれば、バインダとして、ブチラール系樹脂を含むセラミックグリーンシート上に、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α -ターピニルアセテート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、i-カルビルアセテートおよび d-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含む誘電体ペーストを、電極層と相補的なパターンで、印刷して、スペーサ層を形成するように構成され、リモネン、 α -ターピニルアセテート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-ジレドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、I-カルビルアセテートおよびI-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミッ



クグリーンシートにバインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから 、きわめて薄いセラミックグリーンシート上に、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層 を形成する場合においても、誘電体ペーストに含まれた溶剤によって、セラミックグリー ンシートに含まれているバインダが溶解され、セラミックグリーンシートが膨潤し、ある いは、部分的に溶解して、セラミックグリーンシートとスペーサ層との界面に空隙が生じ たり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることを確実に防止することができ 、したがって、セラミックグリーンシートと電極層を含む多数の積層体ユニットを積層体 ユニットを積層して、作製された積層セラミックコンデンサにボイドが発生することを確 実に防止することが可能になるとともに、スペーサ層の表面に生成されたひびや皺の部分 が、積層体ユニットを積層して、積層体を作製する工程で、欠落して、積層体内に異物と して混入し、積層セラミックコンデンサに内部欠陥を生じさせることを確実に防止するこ とが可能になる。

[0045]

また、本実施態様によれば、バインダとして、ブチラール系樹脂を含むセラミックグリ ーンシート上に、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、α-ターピニルアセ テート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、i ーカルビルアセテートおよびd-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少 なくとも一種の溶剤を含む導電体ペーストを、所定のパターンで、印刷して、電極層を形 成するように構成され、リモネン、αーターピニルアセテート、Ιージヒドロカルビルア セテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカルビルアセテートおよびdー ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシート にバインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、きわめて薄いセ ラミックグリーンシート上に、導電体ペーストを印刷して、電極層を形成する場合におい ても、導電体ペースト中に含まれた溶剤によって、セラミックグリーンシートに含まれて いるバインダが溶解されることを効果的に防止することができ、したがって、セラミック グリーンシートの厚さがきわめて薄い場合においても、セラミックグリーンシートにピン ホールやクラックが発生することを効果的に防止して、積層セラミック電子部品に、ショ ート不良が生じることを効果的に防止することが可能になる。

[0046]

本発明の別の好ましい実施態様においては、セラミックグリーンシートを形成するため に用いた長尺状の支持シートとは別の第二の支持シートが用意され、長尺状の第二の支持 シートの表面に、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体材料と実質的に同一組 成の誘電体材料の粒子と、セラミックグリーンシートに含まれているバインダと同一のバ インダを含む誘電体ペーストが、ワイヤーバーコーターなどを用いて、塗布され、乾燥さ れて、剥離層が形成される。

[0047]

第二の支持シートとしては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用 いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコー ティングされる。

[0048]

剥離層の厚さは、電極層の厚さ以下であることが好ましく、好ましくは、電極層の厚さ の約60%以下、さらに好ましくは、電極層の厚さの約30%以下である。

[0049]

剥離層が乾燥された後、剥離層の表面上に、内部電極用の導電体ペーストが、スクリー ン印刷機やグラビア印刷機などを用いて、所定のパターンで印刷され、乾燥されて、電極 層が形成される。

[0050]

電極層は、約0. 1μ mないし約 5μ mの厚さに形成されることが好ましく、より好ま しくは、約0.1μmないし約1.5μmである。

[0051]



本実施態様において、導電体ペーストは、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α - α -

[0052]

リモネン、 α ーターピニルアセテート、I ージヒドロカルビルアセテート、I ーメントン、I ーペリリルアセテート、i ーカルビルアセテートおよび d ージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートにバインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、セラミックグリーンシートと同じバインダを含む剥離層を形成し、剥離層上に、導電体ペーストを印刷して、電極層を形成する場合にも、剥離層が膨潤し、あるいは、部分的に溶解し、剥離層と電極層との界面に空隙が生じたり、あるいは、電極層の表面にひびや皺が生じることを効果的に防止することが可能になる。

[0053]

導電体ペーストに含まれるアクリル系樹脂の分子量は、45万以上、90万以下であることが好ましく、分子量が45万以上、90万以下のアクリル系樹脂を、導電体ペーストのバインダとして用いることによって、所望の粘度を有する導電体ペーストを調製することができる。

[0054]

また、導電体ペーストに含まれるアクリル系樹脂の酸価は $5 \, \mathrm{mg} \, \mathrm{KOH} / \mathrm{g}$ 以上、 $2 \, 5 \, \mathrm{mg} \, \mathrm{KOH} / \mathrm{g}$ 以下であることが好ましく、酸価が $5 \, \mathrm{mg} \, \mathrm{KOH} / \mathrm{g}$ 以上、 $2 \, 5 \, \mathrm{mg} \, \mathrm{KO}$ H/g以下アクリル系樹脂を、導電体ペーストのバインダとして用いることによって、所望の粘度を有する導電体ペーストを調製することができる。

[0055]

電極層の形成に先立って、あるいは、電極層を形成して、乾燥した後に、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α ーターピニルアセテート、I ージヒドロカルビルアセテート、I ーメントン、I ーペリリルアセテート、i ーカルビルアセテートおよび d ージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含む誘電体ペーストが、第二の支持シートの表面に、電極層と相補的なパターンで、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などを用いて、印刷され、スペーサ層が形成される。

[0056]

このように、セラミックグリーンシートの表面に、電極層と相補的なパターンで、スペーサ層を形成することによって、電極層の表面と、電極層が形成されていないセラミックグリーンシートの表面との間に、段差が形成されることを防止することができ、それぞれが、セラミックグリーンシートと電極層を含む多数の積層体ユニットを積層体ユニットを積層して、作製された積層セラミックコンデンサなどの積層電子部品が変形を起こすことを効果的に防止することが可能になるとともに、デラミネーションの発生を効果的に防止することが可能になる。

[0057]

また、上述のように、リモネン、 α ーターピニルアセテート、I ージヒドロカルビルアセテート、I ーメントン、I ーペリリルアセテート、i ーカルビルアセテートおよび d ージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートにバインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、セラミックグリーンシートと同じバインダを含む剥離層を形成し、剥離層上に、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合にも、剥離層が膨潤し、あるいは、部分的に溶解し、剥離層とスペーサ層との界面に空隙が生じたり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることを効果的に防止することが可能になる。

[0058]

さらに、長尺状の第三の支持シートが用意され、接着剤溶液が、バーコータ、エクストルージョンコータ、リバースコータ、ディップコーター、キスコーターなどによって、第



三の支持シートの表面に塗布され、乾燥されて、接着層が形成される。

[0059]

好ましくは、接着剤溶液は、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系のバインダと、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体材料の粒子と実質的に同一の組成を有し、その粒径が、接着層の厚さ以下の誘電体材料の粒子と、可塑剤と、帯電防止剤と、剥離剤とを含んでいる。

[0060]

接着層は、約 0.3μ m以下の厚さに形成されることが好ましく、より好ましくは、約 0.02μ mないし約 0.3μ m、さらに好ましくは、約 0.02μ mないし約 0.2μ mの厚さを有するように形成される。

[0061]

こうして、長尺状の第三の支持シート上に形成された接着層は、長尺状の第二の支持シート上に形成された電極層もしくは電極層およびスペーサ層または支持シート上に形成されたセラミックグリーンシートの表面に接着され、接着後、接着層から第三の支持シートが剥離されて、接着層が転写される。

[0062]

接着層が、電極層あるいは電極層およびスペーサ層の表面に転写された場合には、長尺 状の支持シートの表面に形成されたセラミックグリーンシートが、接着層の表面に接着され、接着後に、セラミックグリーンシートから支持シートが剥離されて、セラミックグリーンシートが接着層の表面に転写され、セラミックグリーンシートおよび電極層を含む積層体ユニットが作成される。

[0063]

こうして得られた積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、電極層あるいは電極層およびスペーサ層の表面に、接着層を転写したのと同様にして、接着層が転写され、その表面に、接着層が転写された積層体ユニットが、所定のサイズに裁断される。

[0064]

同様にして、その表面に、接着層が転写された所定の数の積層体ユニットが作製され、 所定の数の積層体ユニットが積層されて積層体ブロックが作製される。

[0065]

積層体ブロックを作製するにあたっては、まず、積層体ユニットが、ポリエチレンテレフタレートなどによって形成された支持体上に、積層体ユニットの表面に転写された接着層が支持体に接するように位置決めされ、プレス機などによって、加圧されて、積層体ユニットが、接着層を介して、支持体上に接着される。

[0066]

その後、第二の支持シートが剥離層から剥離され、支持体上に、積層体ユニットが積層される。

[0067]

次いで、支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層の表面に、表面に形成された接着層が接するように、新たな積層体ユニットが位置決めされ、プレス機などによって、加圧されて、支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層に、接着層を介して、新たな積層体ユニットが積層され、その後に、新たな積層体ユニットの剥離層から、第二の支持シートが剥離される。

[0068]

同様のプロセスを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが積層された積層体ブロックが作製される。

[0069]

一方、接着層が、セラミックグリーンシートの表面に転写された場合には、第二の支持シート上に形成された電極層あるいは電極層およびスペーサ層が、接着層の表面に接着され、接着後に、剥離層から第二の支持シートが剥離されて、電極層あるいは電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が接着層の表面に転写され、セラミックグリーンシートおよび



電極層を含む積層体ユニットが作成される。

[0070]

こうして得られた積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、電極層あるい は電極層およびスペーサ層の表面に、接着層を転写したのと同様にして、接着層が転写さ れ、その表面に、接着層が転写された積層体ユニットが、所定のサイズに裁断される。

[0071]

同様にして、その表面に、接着層が転写された所定の数の積層体ユニットが作製され、 所定の数の積層体ユニットが積層されて積層体ブロックが作製される。

[0072]

積層体プロックを作製するにあたっては、まず、積層体ユニットが、ポリエチレンテレ フタレートなどによって形成された支持体上に、積層体ユニットの表面に転写された接着 層が支持体に接するように位置決めされ、プレス機などによって、加圧されて、積層体ユ ニットが、接着層を介して、支持体上に接着される。

[0073]

その後、支持シートがセラミックグリーンシートから剥離され、支持体上に、積層体ユ ニットが積層される。

[0074]

次いで、支持体上に積層された積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、 表面に形成された接着層が接するように、新たな積層体ユニットが位置決めされ、プレス 機などによって、加圧されて、支持体上に積層された積層体ユニットのセラミックグリー ンシートに、接着層を介して、新たな積層体ユニットが積層され、その後に、新たな積層 体ユニットのセラミックから、支持シートが剥離される。

[0075]

同様のプロセスを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが積層された積層体ブロック が作製される。

[0076]

こうして作製された所定の数の積層体ユニットを含む積層体ブロックは、積層セラミッ クコンデンサの外層上に積層され、さらに、積層体ブロック上に、他方の外層が積層され 、得られた積層体が、プレス成形され、所定のサイズに裁断されて、多数のセラミックグ リーンチップが作製される。

[0077]

こうして作製されたセラミックグリーンチップは、還元ガス雰囲気下に置かれて、バイ ンダが除去され、さらに、焼成される。

[0078]

次いで、焼成されたセラミックグリーンチップに、必要な外部電極などが取り付けられ て、積層セラミックコンデンサが作製される。

[0079]

本実施態様によれば、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、αーターピニ ルアセテート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテー ト、iーカルビルアセテートおよびdージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ば れる少なくとも一種の溶剤を含む誘電体ペーストを用いて、スペーサ層が形成され、リモ ネン、 α - γ - ーペリリルアセテート、 i ーカルビルアセテートおよび d ージヒドロカルビルアセテート よりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートに、バインダとして含まれる ブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、セラミックグリーンシートと同じバインダ を含む剥離層を形成し、剥離層上に、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する 場合にも、剥離層が膨潤し、あるいは、部分的に溶解し、剥離層とスペーサ層との界面に 空隙が生じたり、あるいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることを効果的に防止す ることができ、したがって、セラミックグリーンシートと電極層を含む多数の積層体ユニ ットを積層体ユニットを積層して、作製された積層セラミックコンデンサにボイドが発生



することを確実に防止することが可能になるとともに、スペーサ層の表面に生成されたひびや皺の部分が、積層体ユニットを積層して、積層体を作製する工程で、欠落して、積層体内に異物として混入し、積層セラミックコンデンサに内部欠陥を生じさせることを確実に防止することが可能になる。

[0080]

さらに、本実施態様によれば、第二の支持シート上に形成された電極層およびスペーサ 層が乾燥した後に、接着層を介して、セラミックグリーンシートの表面に接着するように 構成されているから、セラミックグリーンシートの表面に、導電体ペーストを印刷して、 電極層を形成し、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成する場合のように、導電 体ペーストや誘電体ペーストがセラミックグリーンシート中に染み込むことがなく、所望 のように、セラミックグリーンシート上に、電極層およびスペーサ層を積層することが可 能になる。

[0081]

また、本実施態様によれば、アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α -ターピニルアセテート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、i-カルビルアセテートおよびd-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含む導電体ペーストを用いて、電極層が形成され、リモネン、 α -ターピニルアセテート、I-ジヒドロカルビルアセテート、I-メントン、I-ペリリルアセテート、i-カルビルアセテートおよびd-ジヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる溶剤は、セラミックグリーンシートに、バインダとして含まれるブチラール系樹脂をほとんど溶解しないから、セラミックグリーンシートと同じバインダを含む剥離層を形成し、剥離層上に、導電体ペーストを印刷して、電極層を形成する場合にも、剥離層にピンホールやクラックが発生することを効果的に防止することができ、積層セラミックコンデンサなどの積層セラミック電子部品に不具合が生じることを効果的に防止することが可能になる。

[0082]

本発明の他の実施態様においては、接着層が、電極層あるいは電極層およびスペーサ層の表面に転写された場合に、長尺状の第二の支持シート上に、剥離層、電極層または電極層およびスペーサ層、接着層ならびにセラミックグリーンシートが積層されて、形成された積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、接着層が転写された後、積層体ユニットが裁断されることなく、接着層に、長尺状の支持シート上に、セラミックグリーンシート、接着層、電極層または電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が積層されて、形成された積層体ユニットの剥離層が接着され、セラミックグリーンシートから支持シートが剥離されて、長尺状の第二の支持シート上に、2つの積層体ユニットが積層される。

[0083]

次いで、2つの積層体ユニットの表面に位置するセラミックグリーンシート上に、第三の支持シート上に形成された接着層が転写され、さらに、接着層に、長尺状の支持シート上に、セラミックグリーンシート、接着層、電極層または電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が積層されて、形成された積層体ユニットの剥離層が接着され、セラミックグリーンシートから支持シートが剥離される。

[0084]

同様のプロセスを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが積層された積層体ユニットセットが作製され、さらに、積層体ユニットセットの表面に位置するセラミックグリーンシートの表面に、第三の支持シート上に形成された接着層が転写された後、所定のサイズに裁断されて、積層体ブロックが作製される。

[0085]

一方、接着層が、セラミックグリーンシートの表面に転写された場合には、長尺状の支持シート上に、セラミックグリーンシート、接着層、電極層または電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が積層されて、形成された積層体ユニットの剥離層の表面に、接着層が転写された後、積層体ユニットが裁断されることなく、接着層に、長尺状の第二の支持シ



ート上に、剥離層、電極層または電極層およびスペーサ層、接着層ならびにセラミックグリーンシートが積層されて、形成された積層体ユニットのセラミックグリーンシートが接着され、剥離層から第二の支持シートが剥離されて、長尺状の支持シート上に、2つの積層体ユニットが積層される。

[0086]

次いで、2つの積層体ユニットの表面に位置する剥離層上に、第三の支持シート上に形成された接着層が転写され、さらに、接着層に、長尺状の第二の支持シート上に、剥離層、電極層または電極層およびスペーサ層、接着層ならびにセラミックグリーンシートが積層されて、形成された積層体ユニットのセラミックグリーンシートが接着され、剥離層から第二の支持シートが剥離される。

[0087]

同様のプロセスを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが積層された積層体ユニットセットが作製され、さらに、積層体ユニットセットの表面に位置するセラミックグリーンシートの表面に、接着層が転写された後、所定のサイズに裁断されて、積層体ブロックが作製される。

[0088]

こうして作製された積層体ブロックを用いて、前記実施態様と同様にして、積層セラミックコンデンサが作製される。

[0089]

本実施態様によれば、長尺状の第二の支持シートあるいは支持シート上に、積層体ユニットを次々に積層して、所定の数の積層体ユニットを含む積層体ユニットセットを作製し、その後に、積層体ユニットセットを所定のサイズに裁断して、積層体ブロックを作成しているから、所定のサイズに裁断された積層体ユニットを1つづつ、積層して、積層体ブロックを作製する場合に比して、積層体ブロックの製造効率を大幅に向上させることが可能になる。

[0090]

本発明のさらに他の実施態様においては、接着層が、電極層あるいは電極層およびスペーサ層の表面に転写された場合に、長尺状の第二の支持シート上に、剥離層、電極層または電極層およびスペーサ層、接着層ならびにセラミックグリーンシートが積層されて、形成された積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、接着層が転写された後、積層体ユニットが裁断されることなく、接着層に、第二の支持シート上に形成された電極層あるいは電極層およびスペーサ層が接着され、剥離層から第二の支持シートが剥離されて、電極層あるいは電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が、接着層の表面に転写される。

[0091]

次いで、接着層の表面に転写された剥離層の表面に、第三の支持シート上に形成された 接着層が転写され、支持シート上に形成されたセラミックグリーンシートが、接着層に接 着され、セラミックグリーンシートから支持シートが剥離されて、セラミックグリーンシ ートが、接着層の表面に転写される。

[0092]

さらに、接着層の表面に転写されたセラミックグリーンシートの表面に、第三の支持シート上に形成された接着層が転写され、第二の支持シートシート上に形成された電極層あるいは電極層およびスペーサ層が、接着層に接着され、剥離層から第二の支持シートが剥離されて、電極層あるいは電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が、接着層の表面に転写される。

[0093]

同様のプロセスを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが積層された積層体ユニットセットが作製され、さらに、積層体ユニットセットの表面に位置するセラミックグリーンシートの表面に、接着層が転写された後、所定のサイズに裁断されて、積層体ブロックが作製される。



[0094]

一方、接着層が、セラミックグリーンシートの表面に転写された場合には、長尺状の支持シート上に、セラミックグリーンシート、接着層、電極層または電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が積層されて、形成された積層体ユニットの剥離層の表面に、接着層が転写された後、積層体ユニットが裁断されることなく、接着層に、支持シート上に形成されたセラミックグリーンシートが接着され、セラミックグリーンシートから支持シートが剥離されて、セラミックグリーンシートが、接着層の表面に転写される。

[0095]

次いで、接着層の表面に転写されたセラミックグリーンシートの表面に、第三の支持シート上に形成された接着層が転写され、第二の支持シート上に形成された電極層または電極層およびスペーサ層が、接着層に接着され、剥離層から第二の支持シートが剥離されて、電極層あるいは電極層およびスペーサ層ならびに剥離層が、接着層の表面に転写される

[0096]

さらに、接着層の表面に転写された剥離層の表面に、第三の支持シート上に形成された接着層が転写され、支持シートシート上に形成されたセラミックグリーンシートが、接着層に接着され、セラミックグリーンシートから支持シートが剥離されて、セラミックグリーンシートが、接着層の表面に転写される。

[0097]

同様のプロセスを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが積層された積層体ユニットセットが作製され、さらに、積層体ユニットセットの表面に位置する剥離層の表面に、接着層が転写された後、所定のサイズに裁断されて、積層体ブロックが作製される。

[0098]

こうして作製された積層体プロックを用いて、前記実施態様と同様にして、積層セラミックコンデンサが作製される。

[0099]

本実施態様によれば、長尺状の第二の支持シートあるいは支持シート上に形成された積層体ユニットの表面上に、接着層の転写、電極層または電極層およびスペーサ層ならびに剥離層の転写、接着層の転写ならびにセラミックグリーンシートの転写を繰り返して、積層体ユニットを次々に積層して、所定の数の積層体ユニットを含む積層体ユニットセットを作製し、その後に、積層体ユニットセットを所定のサイズに裁断して、積層体ブロックを作成しているから、所定のサイズに裁断された積層体ユニットを1つづつ、積層して、積層体ブロックを作製する場合に比して、積層体ブロックの製造効率を大幅に向上させることが可能になる。

[0100]

以下、本発明の効果をより明瞭なものとするため、実施例および比較例を掲げる。

【実施例】

[0101]

実施例1

セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストの調製

1. 48重量部の(BaCa) SiO₃ と、1. 01重量部のY₂O₃ と、0. 72重量部のMgCO₃ と、0. 13重量部のMnOと、0. 045重量部のV₂O₅ を混合して、添加物粉末を調製した。

[0102]

こうして調製した添加物粉末100重量部に対して、72.3重量部のエチルアルコールと、72.3重量部のプロピルアルコールと、25.8重量部のキシレンと、0.93重量部のポリエチレングリコール系分散剤を混合して、スラリーを調製し、スラリー中の添加物を粉砕した。

[0103]

スラリー中の添加物の粉砕にあたっては、11.65gのスラリーと、450gのZr 出証特2005-3003393



〇2ビーズ(直径2mm)を、250ccのポリエチレン容器内に充填し、周速45m/ 分で、ポリエチレン容器を回転させて、16時間にわたって、スラリー中の添加物を粉砕 して、添加物スラリーを調製した。

[0104]

粉砕後の添加物のメディアン径は 0. 1 μ mであった。

次いで、15重量部のポリビニルブチラール(重合度1450、ブチラール化度69%)を、50℃で、42.5重量部のエチルアルコールと42.5重量部のプロピルアルコ ールに溶解して、有機ビヒクルの15%溶液を調製し、さらに、以下の組成を有するスラ リーを、500ccのポリエチレン容器を用いて、20時間にわたって、混合し、誘電体 ペーストを調製した。混合にあたって、ポリエチレン容器内に、330.1gのスラリー と、900gのZrO2ビーズ(直径2mm)を充填し、周速45m/分で、ポリエチレ ン容器を回転させた。

[0106]

BaTiO3粉末(堺化学工業株式会社製:商品名「BT-02」:粒径0.2μm)

100重量部 11.65重量部 添加物スラリー 35.32重量部 エチルアルコール 35.32重量部 プロピルアルコール 16.32重量部 キシレン 2.61重量部 フタル酸ベンジルブチル(可塑剤) 7.3重量部 ミネラルスピリット 2.36重量部 ポリエチレングリコール系分散剤 0.42重量部 イミダゾリン系帯電助剤 3 3 . 7 4 重量部

有機ビヒクル

メチルエチルケトン

2-ブトキシエチルアルコール

[0 1 0 7]

ポリエチレングリコール系分散剤としては、ポリエチレングリコールを脂肪酸で変性し た分散剤(HLB=5~6)を用いた。

[0108]

セラミックグリーンシートの形成

得られた誘電体ペーストを、ダイコータを用いて、50m/分の塗布速度で、ポリエチ レンテレフタレートフィルム上に塗布して、塗膜を生成し、80℃に保持された乾燥炉中 で、得られた塗膜を乾燥して、 1 μ mの厚さを有するセラミックグリーンシートを形成し た。

[0109]

スペーサ層用の誘電体ペーストの調製

1. 48重量部の (BaCa) SiO3 と、1. 01重量部のY2O3 と、0. 72重 量部のMgCO3と、0.13重量部のMnOと、0.045重量部のV2O5を混合し て、添加物粉末を調製した。

[0110]

こうして調製した添加物粉末100重量部に対して、150重量部のアセトンと、10 4. 3重量部のリモネンと、1. 5重量部のポリエチレングリコール系分散剤を混合して 、スラリーを調製し、アシザワ・ファインテック株式会社製粉砕機「LMZ0.6」(商 品名)を用いて、スラリー中の添加物を粉砕した。

[0111]

スラリー中の添加物の粉砕にあたっては、Ζ r O 2 ビーズ(直径 0. 1 m m)を、ベッ セル内に、ベッセル容量に対して、80%になるように充填し、周速14m/分で、ロー ターを回転させ、スラリーを、全スラリーがベッセルに滞留する時間が5分になるまで、

43.81重量部

43.81重量部



ベッセルとスラリータンクとの間を循環させて、スラリー中の添加物を粉砕した。

[0112]

粉砕後の添加物のメディアン径は 0. 1 μ mであった。

[0113]

次いで、エバポレータを用いて、アセトンを蒸発させて、スラリーから除去し、添加物 がリモネンに分散された添加物ペーストを調製した。添加物ペースト中の不揮発成分濃度 は49.3重量%であった。

[0114]

次いで、8重量部の酸価5mgKOH/gのメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルの コポリマー (共重合比82:18、分子量70万)を、70℃で、92重量部のリモネン に溶解して、有機ビヒクルの8%溶液を調製し、さらに、以下の組成を有するスラリーを 、ボールミルを用いて、16時間わたって、分散した。分散条件は、ミル中のZrO2(直径2.0mm)の充填量を30容積%、ミル中のスラリー量を60容積%とし、ボール ミルの周速は45m/分とした。

[0115]

添加物ペースト

BaTiO3粉末(堺化学工業株式会社製:商品名「BT-02]:粒径0.2μm)

8.87重量部

95.70重量部

104.36重量部

1. 0 重量部

2.61重量部

0. 4 重量部

57.20重量部

有機ビヒクル

ポリエチレングリコール系分散剤

フタル酸ジオクチル(可塑剤) イミダゾリン系界面活性剤

アセトン

[0116]

次いで、エバポレータおよび加熱機構を備えた攪拌装置を用いて、こうして得られたス ラリーから、アセトンを蒸発させて、混合物から除去し、誘電体ペーストを得た。

[0117]

スペーサ層の形成

こうして調製した誘電体ペーストを、スクリーン印刷機を用いて、所定のパターンで、 セラミックグリーンシート上に、所定のパターンで、印刷し、90℃で、5分間にわたっ て、乾燥させ、セラミックグリーンシート上に、スペーサ層を形成した。

[0118]

金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、スペーサ層の表面を観察したところ、スペ ーサ層の表面に、ひびや皺は観察されなかった。

[0119]

電極用の導電体ペーストの調製

1. 48重量部の(BaCa) SiO3 と、1. 01重量部のY2 O3 と、0. 72重 量部のMgCO3と、0.13重量部のMnOと、0.045重量部のV2O5を混合し て、添加物粉末を調製した。

[0120]

こうして調製した添加物粉末100重量部に対して、150重量部のアセトンと、10 4. 3 重量部のリモネンと、1. 5 重量部のポリエチレングリコール系分散剤を混合して 、スラリーを調製し、アシザワ・ファインテック株式会社製粉砕機「LMZ0.6」(商 品名)を用いて、スラリー中の添加物を粉砕した。

[0121]

スラリー中の添加物の粉砕にあたっては、ZrО₂ビーズ(直径0.1mm)を、ベッ セル内に、ベッセル容量に対して、80%になるように充填し、周速14m/分で、ロー ターを回転させ、スラリーを、全スラリーがベッセルに滞留する時間が5分になるまで、 ベッセルとスラリータンクとの間を循環させて、スラリー中の添加物を粉砕した。

[0122]



粉砕後の添加物のメディアン径は 0. 1 μ mであった。

[0123]

次いで、エバポレータを用いて、アセトンを蒸発させて、スラリーから除去し、添加物がリモネンに分散された添加物ペーストを調製した。添加物ペースト中の不揮発成分濃度は49.3重量%であった。

[0124]

次いで、8重量部の酸価5mgKOH/gのメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマー(共重合比82:18、分子量70万)を、70℃で、92重量部のリモネンに溶解して、有機ビヒクルの8%溶液を調製し、さらに、以下の組成を有するスラリーを、ボールミルを用いて、16時間わたり、分散した。分散条件は、ミル中のZrO2(直径2.0mm)の充填量を30容積%、ミル中のスラリー量を60容積%とし、ボールミルの周速は45m/分とした。

[0125]

川鉄工業株式会社製のニッケル粉末(粒径0.2 μ m) 100重量部 添加物ペースト 1.77重量部

BaTiO3粉末(堺化学工業株式会社製:粒径0.05μm)

有機ビヒクル

ポリエチレングリコール系分散剤 フタル酸ジオクチル (可塑剤) リモネン アセトン 19.14重量部56.25重量部

1. 19重量部
 2. 25重量部

83.96重量部

5 6 重量部

[0126]

次いで、エバポレータおよび加熱機構を備えた攪拌装置を用いて、こうして得られたスラリーから、アセトンを蒸発させて、混合物から除去し、導電体ペーストを得た。導体ペースト中の導電体材料濃度は47重量%であった。

[0127]

電極層の形成および積層体ユニットの作製

こうして調製した導電体ペーストを、スクリーン印刷機を用いて、セラミックグリーンシート上に印刷し、90 $\mathbb C$ で、5 分間わたり、乾燥して、1 μ m の厚さを有する電極層を形成し、ポリエチレンテレフタレートフィルムの表面に、セラミックグリーンシートと電極層が積層された積層体ユニットを作製した。

[0128]

金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層の表面を観察したところ、ひびや皺は観察されなかった。

[0129]

セラミックグリーンチップの作製

上述のように、調製した誘電体ペーストを、ダイコータを用いて、ポリエチレンテレフタレートフィルムの表面に塗布して、塗膜を形成し、塗膜を乾燥して、 10μ mの厚さを有するセラミックグリーンシートを形成した。

[0130]

こうして作製した 10μ mの厚さを有するセラミックグリーンシートを、ポリエチレンテレフタレートフィルムから剥離して、裁断し、裁断した5枚のセラミックグリーンシートを積層して、 50μ mの厚さを有するカバー層を形成し、さらに、積層体ユニットを、ポリエチレンテレフタレートフィルムから剥離して、裁断し、裁断した50枚の積層体ユニットを、カバー層上に積層した。

[0131]

次いで、 10μ mの厚さを有するセラミックグリーンシートを、ポリエチレンテレフタレートフィルムから剥離して、裁断し、裁断した 5 枚のセラミックグリーンシートを、積層された積層体ユニット上に積層して、 50μ mの厚さを有する下部カバー層と、 1μ m



の厚さを有するセラミックグリーンシートと $1\,\mu$ mの厚さを有する電極層および $1\,\mu$ mの厚さを有するスペーサ層を含む $5\,0$ 枚の積層体ユニットが積層された $1\,0\,0\,\mu$ mの厚さを有する有効層と、 $5\,0\,\mu$ mの厚さを有する上部カバー層とが積層された積層体を作製した

[0132]

さらに、こうして得られた積層体を、70℃の温度条件下で、100MPaの圧力を加えて、プレス成形し、ダイシング加工機によって、所定のサイズに裁断し、セラミックグリーンチップを作製した。

[0133]

同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製した。

[0134]

積層セラミックコンデンササンプルの作製

こうして作製されたセラミックグリーンチップを、空気中において、以下の条件で処理 し、バインダを除去した。

[0135]

昇温速度:50℃/時間

保持温度:240℃ 保持時間:8時間

[0136]

バインダを除去した後、セラミックグリーンチップを、露点20℃に制御された窒素ガスと水素ガスの混合ガスの雰囲気下において、以下の条件で処理し、焼成した。混合ガス中の窒素ガスおよび水素ガスの含有量は95容積%および5容積%とした。

[0 1 3 7]

昇温速度:300℃/時間

保持温度:1200℃

保持時間: 2時間

冷却速度:300℃/時間

[0138]

さらに、焼成したセラミックグリーンチップに、露点20℃に制御された窒素ガスの雰囲気下において、以下の条件で、アニール処理を施した。

[0139]

昇温速度:300℃/時間

保持温度:1000℃

保持時間: 3時間

冷却速度:300℃/時間

[0140]

こうしてアニール処理が施されたセラミックグリーンチップを、2液硬化性エポキシ樹脂に、その側面が露出するように、埋め込み、2液硬化性エポキシ樹脂を硬化させ、サンドペーパーを用いて、1.6mmだけ、研磨した。サンドペーパーとしては、#400のサンドペーパー、#800のサンドペーパー、#1000のサンドペーパーおよび#200のサンドペーパーを、この順に用いた。

[0 1 4 1]

次いで、 $1 \mu m$ のダイヤモンドペーストを用いて、研磨された面を鏡面研磨処理し、光学顕微鏡によって、セラミックグリーンチップの研磨された面を、400倍に拡大して、ボイドの有無を観察した。

[0142]

その結果、合計50個のセラミックグリーンチップのいずれにも、ボイドの存在は認め られなかった。

[0143]

こうして得られた燒結体の端面を、サンドブラストによって研磨した後、In-Ga合 出証特2005-3003393



金を塗布して、端子電極を形成し、積層セラミックコンデンササンプルを作製した。

[0144]

同様にして、合計50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製した。

[0145]

ショート率の測定

こうして作製した50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメー タによって、測定して、積層セラミックコンデンササンプルのショート不良を検査した。

[0146]

得られた抵抗値が100kΩ以下のものをショート不良とし、ショート不良が認められ、 た積層セラミックコンデンササンプル数を求め、積層セラミックコンデンササンプルの総 数に対する割合(%)を算出して、ショート率を測定した。

[0147]

その結果、ショート率は16%であった。

[0148]

実施例2

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、αーターピニルアセテートを用いた点を除き、実施例 1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペーサ層および電極層を形成し、金 属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層およびスペーサ層の表面を観察したとこ ろ、ひびや皺は観察されなかった。

[0149]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、ボイドの存在は観察されなかった。

[0150]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 5 0 個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 14%であった。

[0151]

実施例3

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、I-ジヒドロカルビルアセテートを用いた点を除き、 実施例1と同様にして、実施例1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペー サ層および電極層を形成し、金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層およびス ペーサ層の表面を観察したところ、ひびや皺は観察されなかった。

[0152]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、ボイドの存在は観察されなかった。

[0153]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 、50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 18%であった。

[0154]

実施例 4

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、I-メントンを用いた点を除き、実施例1と同様にし て、実施例1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペーサ層および電極層を



形成し、金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層およびスペーサ層の表面を観 察したところ、ひびや皺は観察されなかった。

[0155]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、ボイドの存在は観察されなかった。

[0156]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 、50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 10%であった。

[0157]

実施例5

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、I-ペリリルアセテートを用いた点を除き、実施例1 と同様にして、実施例1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペーサ層およ び電極層を形成し、金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層およびスペーサ層 の表面を観察したところ、ひびや皺は観察されなかった。

[0158]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、ボイドの存在は観察されなかった。

[0159]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 、50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 16%であった。

[0160]

実施例6

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、 i ーカルビルアセテートを用いた点を除き、実施例 1 と同様にして、実施例1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペーサ層およ び電極層を形成し、金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層およびスペーサ層 の表面を観察したところ、ひびや皺は観察されなかった。

[0161]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、ボイドの存在は観察されなかった。

[0162]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 、50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 8%であった。

[0163]

実施例7

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、dージヒドロカルビルアセテートを用いた点を除き、 実施例1と同様にして、実施例1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペー サ層および電極層を形成し、金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層およびス ペーサ層の表面を観察したところ、ひびや皺は観察されなかった。



[0164]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、ボイドの存在は観察されなかった。

[0165]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 10%であった。

[0166]

比較例1

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、ターピオネールとケロシンの混合溶剤(混合比50: 50)を用いた点を除き、実施例1と同様にして、セラミックグリーンシート上に、スペ ーサ層および電極層を形成し、金属顕微鏡を用いて、400倍に拡大して、電極層および スペーサ層の表面を観察したところ、電極層およびスペーサ層の表面に、ひびと皺の発生 が認められた。

[0167]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、50個のセラミックグリーンチップのうち、17個の セラミックグリーンチップにボイドの存在が認められた。

[0168]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し 、50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 90%であった。

[0169]

比較例 2

スペーサ層用の誘電体ペーストを調製する際の溶剤および導電体ペーストを調製する際 の溶剤として、リモネンに代えて、ターピオネールを用いた点を除き、実施例1と同様に して、セラミックグリーンシート上に、スペーサ層および電極層を形成し、金属顕微鏡を 用いて、400倍に拡大して、電極層およびスペーサ層の表面を観察したところ、電極層 およびスペーサ層の表面に、ひびと皺の発生が認められた。

[0170]

次いで、実施例1と同様にして、合計50個のセラミックグリーンチップを作製して、 焼成処理およびアニール処理を施したセラミックグリーンチップの側面を研磨し、光学顕 微鏡で、研磨面を観察したところ、50個のセラミックグリーンチップのうち、23個の セラミックグリーンチップにボイドの存在が認められた。

[0171]

さらに、実施例1と同様にして、50個の積層セラミックコンデンササンプルを作製し . 50個の積層セラミックコンデンササンプルの抵抗値を、マルチメータによって、測定 して、積層セラミックコンデンササンプルのショート率を測定したところ、ショート率は 88%であった。

[0172]

実施例1ないし7ならびに比較例1および2から、バインダとして、ポリビニルプチラ ール(重合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成した セラミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチル のコポリマーをバインダとして含み、ターピオネールとケロシンの混合溶剤(混合比50 :50)を溶剤として含む誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70



万のメタクリル酸メチルとアクリル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、ターピ オネールとケロシンの混合溶剤 (混合比50:50) を溶剤として含む導電体ペーストを 印刷して、電極層を形成した場合およびバインダとして、ポリビニルブチラール(重合度 1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグ リーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマー をバインダとして含み、ターピオネールを溶剤として含む誘電体ペーストを印刷して、ス ペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマー をバインダとして含み、ターピオネールを溶剤として含む導電体ペーストを印刷して、電 極層を形成した場合には、スペーサ層の表面および電極層の表面に、ひびや皺が発生し、 焼成後のセラミックグリーンチップにボイドの発生が認められたのに対し、バインダとし て、ポリビニルブチラール(重合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペー ストを用いて形成したセラミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチ ルとアクリル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、リモネンを溶剤として含む誘 電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとア クリル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、リモネンを溶剤として含む導電体ペ ーストを印刷して、電極層を形成した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール(重 合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミッ クグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリ マーをバインダとして含み、αーターピニルアセテートを溶剤として含む誘電体ペースト を印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチ ルのコポリマーをバインダとして含み、α-ターピニルアセテートを溶剤として含む導電 体ペーストを印刷して、電極層を形成した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール (重合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラ ミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコ ポリマーをバインダとして含み、I-ジヒドロカルビルアセテートを溶剤として含む誘電 体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとアク リル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、I-ジヒドロカルビルアセテートを溶 剤として含む導電体ペーストを印刷して、電極層を形成した場合、バインダとして、ポリ ビニルブチラール(重合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用 いて形成したセラミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアク リル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、I-メントンを溶剤として含む誘電体 ペーストを印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリ ル酸ブチルのコポリマーをバインダとして含み、I-メントンを溶剤として含む導電体ペ ーストを印刷して、電極層を形成した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール(重 合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミッ クグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸プチルのコポリ マーをバインダとして含み、Iーペリリルアセテートを溶剤として含む誘電体ペーストを 印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチル のコポリマーをバインダとして含み、Iーペリリルアセテートを溶剤として含む導電体ペ ーストを印刷して、電極層を形成した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール(重 合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミッ クグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸プチルのコポリ マーをバインダとして含み、iーカルビルアセテートを溶剤として含む誘電体ペーストを 印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸プチル のコポリマーをバインダとして含み、 i -カルビルアセテートを溶剤として含む導電体ペ ーストを印刷して、電極層を形成した場合ならびにバインダとして、ポリビニルプチラー ル (重合度1450、プチラール化度69%) を含む誘電体ペーストを用いて形成したセ ラミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルの コポリマーをバインダとして含み、dージヒドロカルビルアセテートを溶剤として含む誘 電体ペーストを印刷して、スペーサ層を形成し、分子量70万のメタクリル酸メチルとア



クリル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、dージヒドロカルビルアセテートを 溶剤として含む導電体ペーストを印刷して、電極層を形成した場合には、スペーサ層の表 面および電極層の表面に、ひびや皺は認められず、焼成後のセラミックグリーンチップに ボイドの発生は認められなかった。

[0173]

これは、比較例1および2において、スペーサ層用の誘電体ペーストの溶剤として用い られたターピオネールとケロシンの混合溶剤(混合比50:50)およびターピオネール が、セラミックグリーンシートを形成するために用いられた誘電体ペーストに含まれたポ リビニルブチラールを溶解するため、セラミックグリーンシートが膨潤し、あるいは、部 分的に溶解して、セラミックグリーンシートとスペーサ層との界面に空隙が生じたり、あ るいは、スペーサ層の表面にひびや皺が生じ、積層体ユニットを積層し、焼成して作製さ れたセラミックグリーンチップ中に、ボイドが発生し、あるいは、積層体ユニットを積層 するプロセスで、ひびや皺が生じたすページ層の部分が欠落して、焼成後のセラミックグ リーンチップ中に、ボイドが発生しやすかったのに対し、実施例1ないし7において、ス ペーサ層用の誘電体ペーストの溶剤として用いられたリモネン、αーターピニルアセテー ト、Iージヒドロカルビルアセテート、Iーメントン、Iーペリリルアセテート、iーカ ルビルアセテートおよび d ージヒドロカルビルアセテートは、セラミックグリーンシート を形成するために用いられた誘電体ペーストに含まれたポリビニルブチラールをほとんど 溶解せず、したがって、スペーサ層の表面にひびや皺が生じることが効果的に防止され、 焼成後のセラミックグリーンチップに、ボイドが発生することが防止されたためと考えら れる。

[0174]

また、実施例1ないし7ならびに比較例1および2から、バインダとして、ポリビニル ブチラール(重合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形 成したセラミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸 ブチルのコポリマーをバインダとして含み、ターピオネールとケロシンの混合溶剤(混合 比50:50)を溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペーストを印刷して、積層 体ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セラミックコンデンサを 作製した場合ならびにバインダとして、ポリビニルブチラール(重合度1450、ブチラ ール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリーンシート上に 、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマーをバインダとして 含み、ターピオネールを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペーストを印刷して 、積層体ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セラミックコンデ ンサを作製した場合には、積層セラミックコンデンサのショート率が著しく高くなるのに 対して、バインダとして、ポリビニルブチラール(重合度1450、ブチラール化度69 %)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリーンシート上に、分子量70 万のメタクリル酸メチルとアクリル酸プチルのコポリマーをバインダとして含み、リモネ ンを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペーストを印刷して、積層体ユニットを 作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セラミックコンデンサを作製した場合 、バインダとして、ポリビニルプチラール(重合度1450、ブチラール化度69%)を 含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリーンシート上に、分子量70万のメ タクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマーをバインダとして含み、αーターピニ ルアセテートを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペーストを印刷して、積層体 ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セラミックコンデンサを作 製した場合、バインダとして、ポリビニルプチラール(重合度1450、プチラール化度 69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリーンシート上に、分子量 70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマーをバインダとして含み、Iージヒドロカルビルアセテートを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペーストを 印刷して、積層体ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セラミッ クコンデンサを作製した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール(重合度1450



、プチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリーンシ ート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマーをバイン ダとして含み、I-メントンを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペーストを印 刷して、積層体ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セラミック コンデンサを作製した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール(重合度1450、 ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリーンシー ト上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸プチルのコポリマーをバインダ として含み、I-ペリリルアセテートを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導電体ペー ストを印刷して、積層体ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して、積層セ ラミックコンデンサを作製した場合、バインダとして、ポリビニルブチラール(重合度 1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成したセラミックグリ ーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルのコポリマーを バインダとして含み、iーカルビルアセテートを溶剤として含む誘電体ペーストおよび導 電体ペーストを印刷して、積層体ユニットを作製し、50枚の積層体ユニットを積層して 、積層セラミックコンデンサを作製した場合ならびにバインダとして、ポリビニルブチラ ール(重合度1450、ブチラール化度69%)を含む誘電体ペーストを用いて形成した セラミックグリーンシート上に、分子量70万のメタクリル酸メチルとアクリル酸ブチル のコポリマーをバインダとして含み、d-ジヒドロカルビルアセテートを溶剤として含む 誘電体ペーストおよび導電体ペーストを印刷して、積層体ユニットを作製し、50枚の積 層体ユニットを積層して、積層セラミックコンデンサを作製した場合には、積層セラミッ クコンデンサのショート率を大幅に低下させることが可能になることが判明した。

[0175]

これは、比較例 1 および 2 において、導電体ペーストの溶剤として用いられたターピオネールとケロシンの混合溶剤(混合比 5 0 : 5 0) およびターピオネールが、セラミックグリーンシートを形成するために用いられた誘電体ペーストに含まれたポリビニルブチラールを溶解するため、セラミックグリーンシートが膨潤し、あるいは、部分的に溶解して、セラミックグリーンシートにピンホールやクラックが発生したのに対し、実施例 1 ないし 7 において、導電体ペーストの溶剤として用いられたリモネン、 α - α

[0176]

本発明は、以上の実施態様および実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 積層セラミック電子部品のスペーサ層に隣接する層に含まれているバインダを溶解することがなく、積層セラミック電子部品に不具合が発生することを効果的に防止することができる積層セラミック電子部品のスペーサ層用の誘電体ペーストを提供する。 【解決手段】 アクリル系樹脂をバインダとして含み、リモネン、 α ーターピニルアセテート、I ージヒドロカルビルアセテート、I ーメントン、I ーペリリルアセテート、i ーカルビルアセテートおよび d ージヒドロカルビルアセテートよりなる群から選ばれる少なくとも一種の溶剤を含むことを特徴とするスペーサ層用の誘電体ペースト。

【選択図】 なし



特願2003-416158

出願人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日

2003年 6月27日

[変更理由]

名称変更

住所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名

TDK株式会社

Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP04/018628

International filing date:

14 December 2004 (14.12.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2003-416158

Filing date:

15 December 2003 (15.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.